

マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ ～ 電子デバイス実装の展望 ～

【主催】

社団法人 日本溶接協会
マイクロソルダリング要員認証委員会、マイクロソルダリング要員評価委員会、マイクロソルダリング教育委員会

【開催日時および会場】

平成 24 年 10 月 30 日（火） 10：30～16：50 於：芝浦工業大学 豊洲キャンパス 交流棟 大講義室

【開催趣旨】

電子・電気製品を支える実装技術は様々な分野で目まぐるしく変化する新技術を採用した製品が作られており、厳しい環境での使用や長期運用など、高い製造技術・材料・評価試験方法・検査方法による高い品質、高い信頼性が求められています。

日本溶接協会では、平成 4 年よりマイクロソルダリング技術の教育および技術資格の認証を行っており、累計で 2 万人を越える皆様にご活用頂いております。その資格取得者を中心に様々な方々に対して、最新のマニュアルソルダリング用機器・材料・評価装置の展

示、最新の技術動向を通じてマイクロソルダリング実装の展開を知って頂く場として、平成 18 年から「マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ」を開催しております。

本年度は資格認証制度の設置から 20 周年の節目を迎えることから、「電子デバイス実装の展望」をテーマに、これまでの実装関連の変遷から最新の情報をご紹介させて頂くことと致しました。事業主や製造責任者の方々にも参加頂き、基盤技術としてのマイクロソルダリング技術・実装技術を深くご理解頂ければ幸いです。

【プログラム】

10:30-10:35	開会の挨拶 マイクロソルダリング教育委員会 委員長 佐藤 武彦
10:35-11:05	「マイクロソルダリング技術資格制度の概要と変遷」 マイクロソルダリング要員評価委員会 委員長 藤本 公三
11:05-11:45	展示品紹介（5分程度／1件）
11:45-13:15	昼食休憩・展示見学
13:15-13:30	マイクロソルダリング技術賞 表彰式
13:30-14:15	「製造業の競争力強化にむけて」 経済産業省 北岡 康夫
14:15-14:45	「海外製造における実装工程管理」 三菱電機(株) 村上 光平
14:45-15:05	休憩・展示見学
15:05-15:45	「電気製品の事故情報にみる安全対策 ～電気製品の事故実態と原因分析～」 (独)製品評価技術基盤機構 菅沼 恵一
15:45-16:15	「鉛フリー化動向（低Ag, 高温Pbフリー）」 千住金属工業(株) 奥野 哲也
16:15-16:45	「環境調和型低温固相接合の確立に向けた有機酸による接合表面改質技術の開発」 群馬大学 小山 真司
16:45-16:50	閉会の挨拶 マイクロソルダリング要員評価委員会 委員長 藤本 公三

※ プログラムの題目・内容は変更になる場合があります。予めご了承願います。

なお、最新詳細情報はホームページ「<http://www.jwes.or.jp/ms/>」を参照願います。

<< お手数ですが、関係各所に回覧願います。 >>